

中科寒武纪科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布新产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2021年1月21日，中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）首次正式公开发布思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器。
- 公司新产品丰富了公司云端产品线，拓宽了公司云端相关市场业务，有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。
- 公司新产品已经取得了小批量订单。客户大批量采购云端智能芯片及加速卡产品前需要通过对该等产品进行较长时间的认证、测试、适配、移植来确认其实际性能和运行稳定性，因此上述新产品实现大批量销售尚需较长的时间周期和前期技术服务投入，存在不确定性。
- 公司新产品在市场中的同类产品包括英伟达的A100和V100 GPU，以及华为海思的Ascend 910。上述产品与公司新产品形成了直接竞争关系，客户导入时间存在重叠，公司新产品的导入可能受到影响；此外，公司新产品在销售网络、软件生态完善程度和用户接受度上与英伟达相比还存在一定差距。思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器面临着未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、新产品基本情况

2021年1月21日，公司首次正式公开发布思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器。

1. 寒武纪思元 290 智能芯片

寒武纪思元 290 智能芯片主要面向训练任务，兼顾推理。采用台积电 7nm 先进制程工艺，集成 460 亿个晶体管，支持 MLUv02 扩展架构，全面支持 AI 训练、推理或混合型人工智能计算加速任务。芯片具备多项关键性技术创新，MLU-Link™ 多芯互联技术，提供高带宽多链接的互连解决方案；HBM2 内存提供 AI 训练中所需的高内存带宽；vMLU 帮助客户实现云端虚拟化及容器级的资源隔离及热迁移。

相比于思元 270 芯片，思元 290 芯片实现峰值算力提升 4 倍、内存带宽提高 12 倍、芯片间通讯带宽提高 19 倍。新架构结合 7nm 制程，思元 290 可提供更优性能功耗比，以及多 MLU 系统的扩展能力。

2. 寒武纪训练智能加速卡 MLU290-M5

寒武纪 MLU290-M5 智能加速卡搭载了思元 290 智能芯片，采用开放加速模块 OAM 设计，具备 64 个 MLU Core，1.23TB/s 内存带宽以及全新 MLU-Link™ 多芯互联技术，在 350W 的最大散热功耗下提供 AI 算力高达 1024 TOPS(INT4)。

3. 寒武纪智能加速器玄思 1000

寒武纪首款智能加速器玄思 1000 包含 4 片思元 290 智能加速卡，最大 AI 算力超过 4100 万亿次每秒(4.1 PetaOPS INT4)，实现 AI 算力计算中心级纵向扩展，满足高性能、高扩展性、灵活性、高鲁棒性的要求。

二、新产品对公司的影响

上述产品是公司生态战略布局下研发的新产品，体现了公司的技术创新力，进一步丰富了公司云端产品线，拓宽了公司云端芯片及加速卡与智能加速器的市场业务。新产品可面向互联网、金融、交通、能源、电力和制造等领域的复杂 AI 应用场景提供充裕算力，推动人工智能赋能产业升级服务，对公司未来的发展将产生积极的影响。

上述新产品已经取得了小批量订单。客户大批量采购云端智能芯片及加速卡产品前需要通过对该等产品进行较长时间的认证、测试、适配、移植来确认其实际性能和运行稳定性，因此上述新产品实现大批量销售尚需较长的时间周期和前期技术服务投入，存在不确定性。

三、相关风险提示

上述新产品在市场中的同类产品包括英伟达的 A100 和 V100 GPU，以及华为海思的 Ascend 910。在客户导入方面，英伟达 V100 和 A100 以及华为海思 Ascend 910 可能更早开始在客户处导入；在销售网络方面，公司成立时间较短，销售网络尚未全面铺开，销售团队仍有待完善，业务覆盖规模及客户覆盖领域需进一步拓展，而英伟达、华为海思均有较为成熟完善的销售网络；在软件生态方面，英伟达凭借长久以来的经验积累以及产品推广，已形成了较为完善的软件生态，用户粘性较高，公司基础系统软件平台 Cambricon Neuware 的生态完善程度及用户接受度与英伟达相比仍有一定差距。思元 290 智能芯片及加速卡、玄思 1000 智能加速器面临着未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日